

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成22年4月15日(2010.4.15)

【公開番号】特開2008-226912(P2008-226912A)

【公開日】平成20年9月25日(2008.9.25)

【年通号数】公開・登録公報2008-038

【出願番号】特願2007-58921(P2007-58921)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/60 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/60 3 2 1 V

【手続補正書】

【提出日】平成22年2月25日(2010.2.25)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

フープ状に巻き取られた板状のワイヤと、拡散領域により素子が作りこまれ、前記素子と電氣的に接続されたボンディング電極が表面に設けられた半導体チップを用意し、

前記ワイヤを所定の長さで切断し、板状リードを形成し、

前記板状リードを保持して、前記半導体チップのボンディング電極に載置固着する事を特徴とした半導体装置の製造方法。

【請求項 2】

フープ状に巻き取られたワイヤと、拡散領域により素子が作りこまれ、前記素子と電氣的に接続されたボンディング電極が表面に設けられた半導体チップを用意し、

前記ワイヤをプレスして板状にし、所定の長さで切断して、板状リードを形成し、

前記板状リードを保持して、前記半導体チップのボンディング電極に載置固着する事を特徴とした半導体装置の製造方法。

【請求項 3】

前記板状リードの切断面に形成されるバリ面が、上に向いて前記半導体チップに設けられる請求項 1 または請求項 2 に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項 4】

前記板状リードは、複数本設けられ、前記複数本の板状リードは、粘着性のテープにより支持されてから前記半導体チップに搭載固着される請求項 1 または請求項 2 に記載の半導体装置の製造方法。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】発明の名称

【補正方法】変更

【補正の内容】

【発明の名称】半導体装置の製造方法。